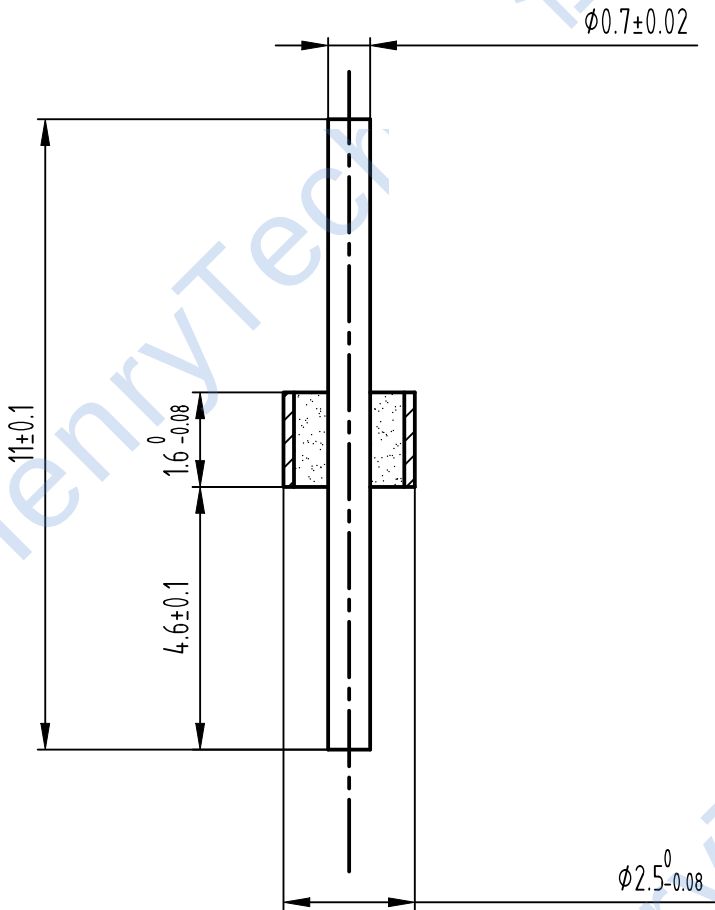




- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 - 4. 使用寿命： ≤ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
 - 6. 镀层厚度： $\geq 1.27\text{ }\mu\text{m}$ 软金

借通用件登记	技术要求： 1. 绝缘电阻：$\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$ 2. 介电耐压：$\geq 300\text{V}$ 3. 密封漏率：$\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$ 4. 使用寿命：≤ 500次 5. 温度范围：$-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$ 6. 镀层厚度：$\geq 1.27\text{ }\mu\text{m}$软金									
描 图										
校 描										
旧底图总号										
签 字						装 配 图			HN-DC2516-0.7(11-4.6)M	
									成都恒利泰科技有限公司	
日 期	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记		重 量	比 例	
	设计	M		标准化					7:1	
	审 核									
	工 艺			日期	2024/5/24	共 页		第 页		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd